

Gold-stud bump bonding - Interconnection technology for research and development of new detectors

Monday 23 February 2015 14:36 (23 minutes)

Presenter: KUDELLA, Simon (Karlsruhe Institute of Technology (KIT); Institut für Experimentelle Kernphysik (IEKP), Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE))

Session Classification: Session 1